|  |
| --- |
| **中国电子材料行 业 协 会** |

**覆铜板材料分会**

|  |
| --- |
| 铜会字（2020）第4号 |

**关于召开“2020年中国覆铜板行业高层论坛”的**

**通 知**

各单位总经理阁下：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）定于2020年7月3日至5日在江苏省苏州市召开“2020年中国覆铜板行业高层论坛”大会。

当我们送走了全球政治、经济发展充满了不稳定性的2019年，迎来2020年全球新冠疫情的爆发、蔓延，遭遇百年未有之大变局。在我国覆铜板产业结构与市场面临重大变化的形势下，我们组织召开本年度高层论坛，具有重大的现实意义。

此次论坛的主题为**“面临大变局，共赢新未来”**。会议将围绕着这一主题，展开以下几方面的深入交流与探讨：如何应对我国覆铜板原材料供需链的格局改变？如何应对我国覆铜板市场结构颠覆性的改变？如何满足5G市场的新需求？我国覆铜板企业如何在大变局下抵御大风险、持续创新求发展？

“2020年中国覆铜板行业高层论坛” 是由中国电子材料行业协会覆铜板材料分会主办，苏州巨峰新材料科技有限公司承办。在本届大会上，将邀请国内覆铜板行业，以及上游原材料、下游PCB行业的著名专家、企业家围绕着大会主题，从不同的视角去作深入的研讨、精彩的阐述。

热诚欢迎贵司派遣中、高层领导及相关人员参会研讨。

**参会代表，必须遵守大会举办地政府的防疫相关规定。**

 本届大会有关事项通知如下：

**一．主办单位：**中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）

**二．承办单位：**苏州巨峰新材料科技有限公司

1. **赞助单位：（征集中）**

苏州巨峰新材料科技有限公司 南亚新材料科技股份有限公司

山东圣泉新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司 诺德投资股份有限公司

广东同宇新材料有限公司 广东生益科技有限公司

建滔积层板控股有限公司 成都科宜高分子科技有限公司

南通图海机械有限公司 西安昱昌环境科技有限公司

南通凯迪自动机械有限公司 江苏瀚高科技有限公司

江苏东材新材料有限责任公司 安徽大松树脂有限公司

美国微觉视检测技术公司 意大利热工机械集团工业处理公司

德国申克博士测试设备有限公司 梅州市威利邦电子科技有限公司

力得机械科技（东莞）有限公司 陕西宝昱科技工业有限公司

理研磨削科技（无锡）有限公司 广州君亮模具科技有限公司

**四．会议日期：**

2020年7月3日至5日（3日全天报到，4日会议，5日疏散。）

**五．会议地址**：

苏州吴江宾馆（苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路2155号） 电话：0512-63420888

**六.会议日程（附后）**

**七.会议费用**

费用包括：会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表：已交会员费单位为1500元/人；未交会员费单位、非会员单位代表为1800元/人。

参会代表可提前将会务费用汇至协会账户，如参会人员有变动，可随后退费或报到现场补交。住宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间。标间：468元/晚/间（含双早），单间：518元/晚/间（含双早），费用自理。

预定住宿联系人：胡洪国 18901550308

**参会代表预先付款方式**：

帐户:中国电子材料行业协会

开户银行:工行北京香河园支行

账 号: 0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便会议报到时及时开票。

**八.会议酒店交通指南：**

**机场：**苏南硕放国际机场，距离酒店约55公里。上海虹桥机场距离酒店约80公里。

**高铁：**苏州火车站 乘坐地铁4号线至江兴西路站 乘坐出租车（起步价）至苏州吴江宾馆。

**九.其他事项**

敬请所有参会代表务必将回执在6月28日前发回秘书处。

**十.联系方式**

**CCLA秘书处联系方式**

联 系 人：王晓艳 13609146084 15667246308（协会微信）

联系电话：029-33335234

电子邮箱：ccla33335234@163.com

**承办单位联系方式：**

苏州巨峰新材料科技有限公司

会务负责人： 吴向荣 18912790479

会务联系人： 彭红丹 18906255896

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

2020年5月25日

**会 议 回执**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **代表姓名** | **职 务** | **手 机** | **电 话** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 是否在“江苏吴江宾馆”住宿？是（ ）/否（ ），已于（ ）月（ ）日预订了单人房（ ）间 双人房（ ）间。 |
| **开票信息：名 称：** **纳税人识别号：****地 址、电 话：****开户行及账号：** |
| **注意** | **1、因房源有限，需要在“江苏吴江宾馆”住宿的代表，务请尽快自行与酒店联系预订房间！联系时请报覆铜板行业协会，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：胡洪国 18901550308。****2、请参会代表准确填写回执表各项信息，****将回执于6月28日前发至****ccla33335234@163.com****或15667246308（协会微信）** |

**会 议 日 程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时 间** | **报告地点、报告人及报告题目** | **主持人** |
| 7月3日（全天） | 参会代表在酒店大厅报到 | 王晓艳 |
| 7月4日8:30～12:00 | **一楼 《8号会议室》** | 李小兰 |
| 主持人介绍参会领导及嘉宾 | 张 东 |
| 中电材协副理事长 覆铜板材料分会理事长 **张 东 致开幕词** |
| 中共吴江区委、政府领导 **致欢迎词** |
| 苏州巨峰新材料科技有限公司董事长 **徐伟红 致欢迎词** |
| 广东生益科技股份有限公司董事长 **刘述峰 建立可控的供应链体系正当其时** |
| 广东省电路板行业协会秘书长 **辛国胜 PCB市场发展对基板材料的新需求** |
| 中兴通讯股份有限公司工艺研究部总工程师 **刘 哲** **5G新基建与PCB、基板材料现状及未来** |
| 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 技术副总经理 **夏 宇****覆铜板原材料企业如何应对5G时代的挑战**   |
| 12:00～13:30 | **午 餐 一楼《爱琴海西餐厅》** | 董榜旗 |
| 7月4日13:30～18:00 | **一楼 《8号会议室》** | 祝大同 |
| 陕西宝昱科技工业有限公司总经理 **钱 研 覆铜板上胶废气治理现状及技术浅析** |
| 北京交通大学电气工程学院 副教授 博导 **田付强** **高导热填料及其改性技术在覆铜板中的应用** |
| 中电材协副秘书长、电子铜箔材料分会秘书长 **冷大光** **2019年我国电子铜箔行业经营状况及未来展望** |
| 中电材协副秘书长、覆铜板材料分会秘书长 **雷正明**  **2019年我国覆铜板行业经营情况调查与分析** |
| 中电材协覆铜板材料分会副秘书长 **祝大同****高端覆铜板用三大关键原材料现况与性能需求** |
| 参观苏州巨峰新材料科技有限公司 | 吴向荣 |
| 18:30～20:00 | **苏州巨峰新材料科技有限公司 招待晚宴 一楼《宴会厅D》**  | 吴向荣 |

**承办单位：苏州巨峰新材料科技有限公司**

**会务负责人： 吴向荣 18912790479 会务联系人： 彭红丹 18906255896**